

证券代码：688535

证券简称：华海诚科

投资者关系活动记录表

投资者关系活动类别	<div><div><input type="checkbox"/>特定对象调研</div><div><input type="checkbox"/>分析师会议</div><div><input type="checkbox"/>媒体采访</div><div><input checked="" type="checkbox"/>业绩说明会</div><div><input type="checkbox"/>新闻发布会</div><div><input type="checkbox"/>路演活动</div><div><input type="checkbox"/>现场参观</div><div><input type="checkbox"/>电话会议</div><div><input type="checkbox"/>其他（请文字说明其他活动内容）</div></div>
参与单位名称及人员姓名	中国国际金融股份有限公司、中软国际、华福证券有限责任公司、开源证券股份有限公司、北京橡果资产管理有限公司等
会议时间	2025 年 10 月 30 日 10：00-11：00
会议地点	线上
上市公司接待人员姓名	董事长、总经理：韩江龙 副总经理、董事会秘书、财务负责人：董东峰 证券事务代表：钱云 证券事务专员：张雅婷
投资者关系活动主要内容介绍	<p>问题一：请问 2025 年环氧塑封料相关营收大概占比是多少？请问封装厂对塑封料的需求以及销售价格有变化吗？</p> <p>回复：公司的主营业务收入主要来源于环氧塑封料。从今年的销售情况来看，公司销售额同比略有增长，价格则基本保持稳定。</p> <p>问题二：公司毛利率有所下降，请问原因是什么？</p> <p>回复：基础类产品的毛利率下降是主要原因。目前国内市场竞争激烈，导致基础类产品毛利率显著下降。未来公司将通过结构调整以及拓宽高性能产品份额，逐步提升毛利率。</p> <p>问题三：阻碍公司拓宽高性能产品份额的原因是什么？除了验证时间很久之外，还有哪些因素？</p> <p>回复： 1.在高性能产品领域，国内大部分是代工模式，材料更</p>

	<p>换需要与上游设计厂商沟通，客户不轻易更换供应商；公司材料处于半导体制造的最后环节，且成本占比较低，客户更换意愿不强烈。</p> <p>问题四：公司半年度及三季度归属于上市公司股东的净利润同比下降都比较多，请问是什么因素导致的？</p> <p>回复：公司半年度及三季度归属于上市公司股东的净利润同比下降主要系员工股权激励费用、新增办公楼及设备折旧费用、重组期间中介机构费用、贷款利息费用等导致的期间费用增加所致。</p> <p>问题五：公司高密度集成电路和系统级模块封装用环氧塑封料募投项目延期的原因是什么？</p> <p>回复：“高密度集成电路和系统级模块封装用环氧塑封料项目”是公司根据下游行业发展趋势、业务发展需求以及公司发展战略等综合因素确定的，且已经过充分的可行性论证。为更好满足对于芯片级、车规级芯片封装对产品性能、金属含量极限控制要求，公司在项目实施中时刻关注行业新设备、新技术的进展动态，对前道预处理工序、后道粉碎及产品去金属杂质提纯工序都采用最新的工艺设备。针对这些新技术设备的应用，公司前期在市场调研、方案设计论证、开发研制样机、试验验证及设备定型上耗用了大量时间和精力，导致部分设备采购时间延期。经充分考虑产品市场需求、项目技改所需时间等因素，公司审慎调整投资计划，在保持募投项目的投资方向、实施主体和实施方式未发生变更的情况下，对“高密度集成电路和系统级模块封装用环氧塑封料项目”进行延期。</p> <p>问题六：该募投项目完成后，预期能达到什么效果？</p> <p>回复：通过该项目实施，公司将进一步发展高端封装材料研发及生产能力，扩大生产规模、改进生产工艺、提高技术水平、完善和优化产品结构，通过不断扩大环氧塑封料产能规模、提高工艺技术水平、拓展产品应用领域，不断增加公司在全球集成电路封装材料市场的占有率，巩固并提升公司所处市场地位，进一步提</p>
--	--

	<p>升公司整体的市场竞争力和影响力。</p> <p>问题七：公司未来发展战略</p> <p>回复：未来，公司将在巩固现有半导体封装材料竞争优势的基础上，以客户定制化需求为牵引，以先进封装技术发展趋势为导向，构建兼具前瞻性与创新性的技术研发体系，持续优化产品结构，增强企业核心竞争力。在传统封装用封装材料领域，公司依托既有优势产品加快对外资厂商产品替代，并积极围绕现有客户以及潜在客户的新增需求进行布局并开发特色产品，从而进一步扩大公司业务规模并提升市场占有率；在先进封装材料领域，公司将加快研发进程，继续完善研发测试手段，缩短研发周期；胶黏剂生产车间将进行净化级别，以提升满足客户对产品颗粒度管控要求。并以此为基础，依托公司在该领域具有创新性与前瞻性的技术与产品布局，积极配合业内主要厂商全面深入开展先进封装材料的技术攻关，逐步实现先进封装用材料全面产业化。</p> <p>公司聚焦于封装材料的研发及产业化，致力于成长为中国半导体以及相关行业封装材料的引领者与全球强有力的竞争者，持续地以打造卓越的全球化企业为目标而努力，为我国半导体及相关行业产业链发展壮大贡献力量。</p> <p>问题八：请问公司收购衡所华威有何战略意义？</p> <p>回复：公司和衡所华威均从事半导体芯片封装材料的研发、生产和销售，主要产品均为环氧塑封料，是半导体封装的关键材料。双方在以下多方面均有协同效应，具体如下： 加速国际化布局，扩大海外优质市场份额；补强产品矩阵，提升客户服务能力；供应链整合，优化采购与运输成本；优化产线布局，提高生产效率；整合研发资源，提高高性能和先进封装用环氧塑封料研发投入。</p> <p>问题九：本次收购衡所华威对公司业务方面的发展前景有何影响？</p> <p>回复：本次交易完成后，有利于公司发挥在资金、市场、经营管</p>
--	---

	<p>理方面的协同，扩大业务规模、提高经营业绩。 本次交易完成后，公司将进一步把握衡所华威的经营计划和业务方向，依据其业务特点，将衡所华威发展规划与公司发展战略深度绑定，通过资源共享和优势互补，整合研发资源、补齐产品矩阵、加速国际化布局，实现业务协同发展，控制采购成本和资金运营成本，促进生产效率、经营水平的提升。</p> <p>注：本次活动不涉及应当披露重大信息的特别说明，其他相关介绍、交流情况可参阅近期《投资者关系活动记录表》之内容和已对外披露正式公告。</p>
附件清单（如有）	无
日期	2025 年 10 月 30 日